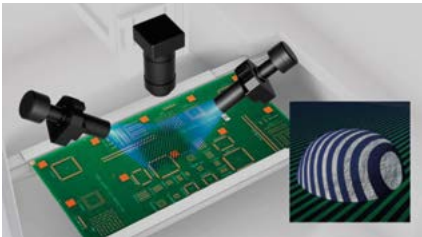




3D-LOTPASTEN-INSPEKTION OMRON CKD VP9000 3D-SPI

Hochgenauer Prozessindikator in der Elektronikproduktion

Das
schnellste
3D-SPI-System
am Markt!



HAUPTMERKMALE

- Echte 3D-Abtastung
- High-Speed-Variante
- Wählbare optische Auflösung (pro FOV)
- Wiederholbare Resultate
- Schnelle und einfache Programmierung
- Umfangreiche Prozesskontrolle





ZUSAMMENFASSUNG

Die VP9000 besteht aus einem modernen Gehäuse, in dem das XYZ-Antriebssystem für den Kamera- und Beleuchtungskopf sowie das Transportband untergebracht sind.

Im Unterschied zu herkömmlichen AOI-Systemen, wird bei dieser SPI mittels eines Interferenzverfahrens die Oberfläche **vermessen** und nicht verglichen. Eine farbige Ringbeleuchtung sorgt für schattenfreie Bilder und wirkt Reflektionen entgegen. Unterschiedliche Höhenprofile ergeben durch einen Phasenversatz präzise Höhenangaben, die zu bewertbaren Volumen aufgearbeitet werden. Auf der Basis von Substratdaten oder durch eine Einlern-Funktion, sind Programme in wenigen Minuten, u.a. per Touch-Screen, zu erstellen und in Bibliotheken zu hinterlegen.

Geographische 2D- und 3D-Farb-Darstellungen (Patent) sind in kürzester Zeit verfügbar und zeigen sehr schnell mögliche Fehleraussagen zum Pastendruck.

Closed-Loop zu Druckern oder Loop-Forward-Funktionen zu bekannten Bestückautomaten sind möglich. Prozessdaten können in Verbindung mit OMRON AOI- und AXI-Lösungen verknüpft werden und bilden damit eine unschlagbare Kombination zur Prozesskontrolle. Einmalig ist die Möglichkeit, die gewählte Auflösung pro FOV zu dritteln, sodass bei Bedarf auch kleinste Strukturen (008004) zu ermitteln sind.

Statistikdaten werden nach ISO9001/ IATF 16949:2016 aufgenommen.

TECHNISCHE DATEN

Systembezeichnung	VP9000
FOV	z.B. 23 x 31 mm bei 12,5 µm Auflösung
Mechanische Auflösung	Horizontal: 0,5 µm, vertikal: 1 µm, Höhe: 0,4 µm (typisch)
Wählbare Kamera-Auflösung	15/7,5/5 µm oder 20/10/7 µm oder 25/12,5/8,5 µm (pro FOV umschaltbar)
Lotpastenhöhenbereich	100 x 100 µm – 6.400 x 4.800 µm
Inspektionsgeschwindigkeit	ca. 1.900 mm ² /s bei 8,5 µm, ca. 5.600 mm ² /s bei 12,5 µm, ca. 8.900 mm ² /s bei 25 µm
Volumengenauigkeit (±3σ)	<2% (Lot GR&R bei ±3σ)
Höhengenauigkeit (±3σ)	Durchschnittshöhe ±3 µm, ±1 µm (Lot GR&R bei ±3σ)
Leiterplattenmaße	50 x 50 mm bis 510 x 460 mm
PCB Transport	Kein Rand notwendig, keine Druckluft nötig
Leiterplattenfreiheit (o/u)	20 mm
Maße	904 x 1.180 x 1.600 mm (W/D/H, ohne Signallampe)
Gewicht	ca. 600 kg

PAGGEN

Ihr Partner für SMD-Technologie

Paggen Werkzeugtechnik GmbH
Söckinger Straße 12 82319 Starnberg
Tel. +49-8151-16190 Fax. - 28554
www.paggen.de info@paggen.de

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008